

Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets



(11) **EP 1 388 380 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

11.02.2004 Patentblatt 2004/07

(51) Int CI.⁷: **B21D 26/02**, C22F 1/08

(21) Anmeldenummer: 03014379.6

(22) Anmeldetag: 26.06.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK

(30) Priorität: 09.08.2002 DE 10237052

(71) Anmelder: KM Europa Metal AG 49074 Osnabrück (DE)

(72) Erfinder:

- Hecht, Meinhard
 49205 Hasbergen (DE)
- Konczalla, Mathias, Dr.-Ing. 49090 Osnabrück (DE)
- Naumann, Ulrich 58706 Menden (DE)

(54) Verwendung einer niedriglegierten Kupferlegierung und hieraus hergestelltes Hohlprofilbauteil

(57) Die Erfindung betrifft die Verwendung einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung (DHP-Cu) für die Herstellung von Hohlprofilbauteilen durch Innenhochdruckumformung, wobei die Kupferlegierung folgende Zusammensetzung aufweist: 0,030 bis 0,080 Gew.-% mindestens eines Elements einer aus Zinn (Sn), Zink (Zn), Eisen (Fe), Silber (Ag) be-

stehenden Gruppe, 0,015 bis 0,040 Gew.-% Phosphor (P) und mindestens 99,90 Gew.-% Kupfer (Cu) sowie unvermeidbaren Verunreinigungen als Rest. Eine solche Kupferlegierung eignet sich durch ihre Kaltverfestigungseigenschaften besonders gut zur Herstellung von Hohlprofilbauteilen durch Innenhochdruckumformung.

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung für die Herstellung von Hohlprofilbauteilen durch Innenhochdruckumformung nach den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowie ein aus der Kupferlegierung hergestelltes Hohlprofilbauteil.

[0002] Unter Innenhochdruckumformung sind Prozesse zu verstehen, bei denen rohrförmige Werkstücke bzw. Hohlprofile unter Wirkmedienunterstützung umgeformt werden. Mit dem Verfahren der Innenhochdruckumformung sind
Hohlprofilbauteile mit verbesserten Eigenschaften in hoher Präzision herstellbar, die mit anderen Verfahren nicht oder
nur mit ungleich höherem Aufwand realisierbar wären. Für die erfolgreiche Anwendung des Verfahrens ist neben der
Auswahl geeigneter Bauteile und Werkstoffe vor allem das Wissen um die Prozeßführungsgrenzen von Bedeutung.
Beispielsweise kann ein zu geringer Innendruck und eine gleichzeitig aufgebrachte zu große Verschiebung der Rohrenden zum Auffalten oder zum Knicken des Werkstücks führen, wohingegen ein starker Innendruck bei zu geringem
Nachschieben der Rohrenden ein Versagen durch Reißen bzw. Bersten nach sich ziehen kann.

[0003] Außer nahtlosen und geschweißten Rohren werden auch alternative rohrförmige Halbzeuge mit dieser Verfahrenskombination erfolgreich umgeformt, wobei neben verschiedenen Stahlwerkstoffen auch Nichteisenmetalle zum Einsatz kommen. Insbesondere zur Herstellung von Fittingen im Rohrleitungsbau kommen sauerstoffreie, mit Phosphor desoxidierte Kupfersorten mit dem EN-Kurzzeichen Cu-DHP zum Einsatz mit einem vorgeschriebenen Restphosphorgehalt von 0,015 bis 0,040 %. DHP-Kupfer ist sehr gut schweiß- und hartlötbar und die wichtigste Kupfersorte im Maschinen, Apparate- und Rohrleitungsbau.

[0004] Obwohl Kupfer sehr duktil also sehr gut kaltverformbar ist und während der Kaltumformung zunehmende Verfestigungen zeigt, kann es zu Problemen bei der Innenhochdruckumformung in Form von Falten und Rissen kommen. Diese Fehler können nicht allein auf die Verfahrensparameter zurückgeführt werden.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, für die Verwendung bei der Innenhochdruckumformung zur Herstellung von Hohlprofilbauteilen eine niedriglegierte phosphordesoxidierte Kupferlegierung aufzuzeigen, welche im unverformten Zustand eine erhöhte Streckgrenze besitzt sowie eine erhöhte Verfestigungsneigung bereits bei geringen Umformgraden aufweist.

[0006] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein durch Innenhochdruckumformung hergestelltes Hohlprofilbauteil mit verbesserten Materialeigenschaften aufzuzeigen.

[0007] Die Erfindung löst den verfahrensmäßigen Teil der Aufgabe durch die Verwendung einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung (Cu-DHP) mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Hiernach soll die Kupferlegierung 0,030 bis 0,080 Gew.-% mindestens eines Elements einer aus Zinn (Sn), Zink (Zn), Eisen (Fe) und Silber (Ag) bestehenden Gruppe besitzen sowie den durch Normung vorgeschriebenen Phosphorgehalt von 0,015 bis 0,040 Gew.-%, sowie wenigstens 99,90 Gew.-% Kupfer und als Rest unvermeidbare Verunreinigungen.

[0008] Durch Versuche hat sich gezeigt, daß das Kaltverfestigungsverhalten von DHP-Cu, insbesondere durch die Zugabe von Zinn, bis an die maximal mögliche Grenze für DHP-Cu erhöht werden kann. Es hat sich auch gezeigt, daß Zugaben in der Größenordnung von Verunreinigungen, also etwa in der Größenordnung von 0,001 Gew.-%, keinen relevanten Einfluß auf das Kaltverfestigungsverhalten haben.

[0009] Vorzugsweise kommen die Elemente Zinn und Zink zum Einsatz, insbesondere in Anteilen von 0,030 bis 0,050 Gew.-%, vorzugsweise Zinn mit einem Massenanteil von 0,050 Gew.-% (Ansprüche 2 und 3). Auch Zugaben von Silber in der Größenordnung von 0,008 bis 0,010 Gew.-% (Ansprüch 4) führen ebenso zu einer Erhöhung der Streckgrenze bzw. der 0,2 %-Dehngrenze. Ebenso verhält es sich bei einer Zulegierung von Silber mit einem Massenanteil von 0,002 bis 0,007 Gew.-% und gleichzeitig von Eisen mit einem Massenanteil von 0,005 bis 0,010 Gew.-% (Ansprüch 5).

[0010] Die im Rahmen der Erfindung als unvermeidbare Verunreinigungen bezeichneten Restgewichtsanteile umfassen die Summe von As, Bi, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, O, Pb, S, Sb, Se, Si und Te.

[0011] Als besonders vorteilhafte wird die Verwendung einer phosphordesoxidierten Kupferlegierung mit einem Gewichtsanteil von 99,90 % bis 99,95 % Kupfer erachtet bei Zulegierung von Zinn in der Größenordnung von 0,030 bis 0,050 Gew.-%, insbesondere von 0,050 Gew.-%.

[0012] Der gegenständliche Teil der Aufgabe wird durch ein Profilbauteil nach den Merkmalen des Patentanspruchs 6 gelöst. Dieses ist aus einem DHP-Kupfer der zuvor beschriebenen Zusammensetzung hergestellt, insbesondere bei einem Zinngehalt von 0,030 bis 0,050 Gew.-%.

[0013] Das Hohlprofilbauteil ist vorzugsweise ein Rohrstück mit wenigstens einem Abzweig, insbesondere ein T-Stück.

Patentansprüche

1. Verwendung einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung für die Herstellung von Hohlprofilbau-

55

20

30

35

40

45

50

EP 1 388 380 A1

teilen durch Innenhochdruckumformung, wobei die Kupferlegierung folgende Zusammensetzung aufweist:

0,030 bis 0,080 Gew%	mindestens eines Elements einer aus Zinn (Sn), Zink (Zn), Eisen (Fe), Silber (Ag) beste-
	henden Gruppe
0,015 bis 0,040 Gew%	Phosphor (P)
>= 99,90 Gew%	Kupfer (Cu)
Rest	unvermeidbare Verunreinigungen.

10

5

- 2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Kupferlegierung 0,030. bis 0,050 Gew.-% Zinn (Sn) aufweist.
- 3. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Kupferlegierung 0,030 bis 0,050 Gew.-% Zink (Zn) aufweist.
- 4. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Kupferlegierung 0,008 bis 0,010 Gew.-% Silber (Ag) aufweist.
 - **5.** Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Kupferlegierung 0,002 bis 0,007 Gew.-% Silber (Ag) und 0,005 bis 0,010 Gew.-% Eisen (Fe) aufweist.
- 6. Hohlprofilbauteil, hergestellt durch Innenhochdruckumformung aus einer niedriglegierten phosphordesoxidierten Kupferlegierung, wobei die Kupferlegierung folgende Zusammensetzung aufweist:

0,030 bis 0,080 Gew%	mindestens eines Elements einer aus Zinn (Sn), Zink (Zn), Eisen (Fe), Silber (Ag) bestehenden Gruppe
0,015 bis 0,040 Gew% >= 99,90 Gew%	Phosphor(P) Kupfer (Cu)
Rest	unvermeidbare Verunreinigungen.

30

25

35

40

45

50

55



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 03 01 4379

	EINSCHLÄGIGI	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokun der maßgebliche	nents mit Angabe, soweit erforderlich n Teile	n, Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.7)
A	PATENT ABSTRACTS OF vol. 005, no. 090 (12. Juni 1981 (1981 & JP 56 036334 A (N LTD), 9. April 1981 * Zusammenfassung *	(M-073), 1-06-12) MATSUSHITA SEIKO CO 1 (1981-04-09)	1,6	B21D26/02 C22F1/08
A	EP 0 439 764 A (EUF 7. August 1991 (199 * Zusammenfassung;	01-08-07)	1,6	,
A	US 5 407 499 A (GRA 18. April 1995 (199 * Ansprüche 1,6,7 *	95-04-18)	1-6	
A	US 2002/005235 A1 (AL) 17. Januar 2002 * Ansprüche 1-7,13	HELMENKAMP THOMAS ET (2002-01-17)	1-6	
A	US 4 284 436 A (STE 18. August 1981 (19 * Zusammenfassung *	981-08-18)	1,6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) B21D C22F C22C
Der vol		rde für alle Patentansprüche erstellt Abschlußdatum der Recherche		Deater
	Recherchenort MINCHEN		,na u	Prüfer
X : von t Y : von t ande A : techi	MÜNCHEN TEGORIE DER GENANNTEN DOKL Desonderer Bedeutung allein betracht Desonderer Bedeutung in Verbindung ren Veröffentlichung derselben Kateg nologischer Hintergrund bschriftliche Offenbarung	E: älteres Pater et nach dem An mit einer D: in der Anmel orie L: aus anderen	z zugrunde liegende T ntdokument, das jedoc meldedatum veröffen dung angeführtes Dol Gründen angeführtes	tlicht worden ist kument Dokument

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 03 01 4379

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-10-2003

	lm Recherchenberio eführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) o Patentfamil		Datum der Veröffentlichung
JΡ	56036334	Α	09-04-1981	KEINE			
EP	0439764	A	07-08-1991	IT AT DE DK EP ES FI JP JP	7039965	T D1 T2 T3 A2 T3 A B2	27-11-1993 15-04-1994 19-05-1994 01-09-1994 29-08-1994 07-08-1991 16-08-1994 03-08-1991 14-08-1996 10-02-1995 24-03-1992
US	5407499	A	18-04-1995	DE AT AT BE CH CH ES FR GBT JP KR SE SZA		B A A1 A1 A5 A1 A A1 A A1 B B B B B1 B	23-10-1986 25-10-1996 15-03-1996 20-10-1986 23-12-1986 02-10-1990 13-07-1990 16-10-1987 20-10-1986 24-10-1986 05-11-1986 16-02-1988 05-06-1987 05-06-1992 14-02-1994 20-10-1986 29-04-1987
US	2002005235	A1	17-01-2002	DE AU BR CA CN CZ EP JP PL TR	10032627 5403801 0102767 2352638 1332258 20012424 1170074 2002053921 348478 200101997	A A1 A A3 A1 A	17-01-2002 10-01-2002 19-02-2002 07-01-2002 23-01-2002 17-07-2002 09-01-2002 19-02-2002 14-01-2002 21-02-2002
US	4284436	Α	18-08-1981	HU AT AT	170948 351276 791176	В	28-10-1977 10-07-1979 15-12-1978

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

EPO FORM P0461

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 03 01 4379

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

15-10-2003

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

EPO FORM P0461